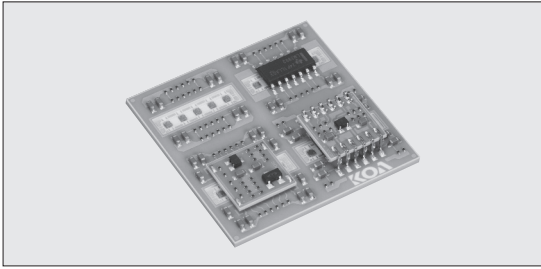
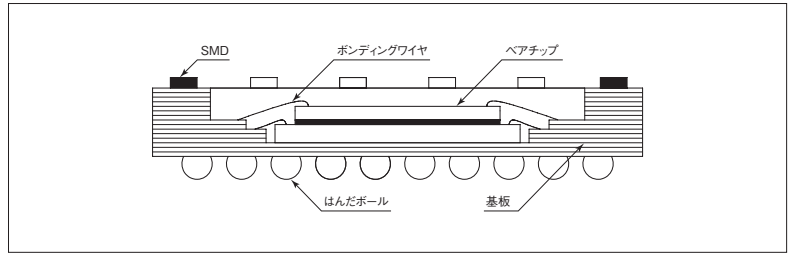


## KLCJ■カスタムモジュール



### ■構造図



### ■特長

- 複数の半導体を1パッケージ組み込むことによるシステムの小型化、高機能化、標準化
- LTCC基板の多層フィンパターンによる配線面積の低減、配線距離の短縮による信号遅延問題の解消
- 外部端子削減による実装不良の低減

### ■実装仕様

項目	単位	minimum	Standard	Maximum	Note
基板外形寸法	mm	—	—	100×100	
基板厚み	mm	0.4	—	2.0	
ペアチップパッドピッチ	μm	100	—	—	
ペアチップパッドサイズ	μm	70	—	—	
ペアチップ厚さ	mm	0.1	0.2	—	
封止高さ	mm	0.3	1.0	1.2	チップ表面からの高さ
ワイヤー長さ	mm	0.3	—	3.0	
ループ高さ	μm	100	200	—	
ワイヤー径	Au μm	20	25	40	
基板表面処理	無電解金めっき				
基板	・LTCC				

### ■パッケージ仕様

項目	内容
端子ピッチ	0.8mm～
搭載可能部品	・SMD ・ペアチップ ・印刷抵抗
対応可能パッケージ	・SON ・BGA ・LGA
パッケージ基材	・LTCC

### ■樹脂封止

ポッティング材	色	Note
エポキシ	黒	

